

目 录

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| 1.0 范围 | 1 | 3.7 质量保证程序 | 4 |
| 1.1 范围 | 1 | 3.7.1 过程控制 | 4 |
| 1.2 性能等级 | 1 | 3.8 材料 | 4 |
| 1.3 尺寸和公差 | 1 | 4.0 质量保证条款 | 4 |
| 1.3.1 当规定极限值时的可接受性 | 1 | 4.1 检验职责 | 4 |
| 1.3.2 修约原则 | 1 | 4.1.1 测试设备与检验设施 | 4 |
| 1.4 对“应当”的说明 | 1 | 4.1.2 合同服务 | 4 |
| 1.5 合同协议 | 1 | 4.2 材料检验 | 4 |
| 2.0 引用文件 | 2 | 4.3 质量一致性验 | 4 |
| 2.1 IPC | 2 | 4.3.1 交付产品的检验 | 4 |
| 2.2 国际标准化组织 | 2 | 4.3.2 质量一致性 | 4 |
| 3.0 要求 | 2 | 4.4 可靠性测试和评价 | 4 |
| 3.1 总则 | 2 | 4.4.1 不合格 | 4 |
| 3.2 术语和定义 | 2 | 5.0 交付准备 | 4 |
| 3.2.1 印制板采购文件 | 2 | 5.1 包装 | 4 |
| 3.3 印制板详细要求 | 2 | 6.0 注 | 5 |
| 3.3.1 生产底版 | 2 | 6.1 统计过程控制（SPC） | 5 |
| 3.4 偏离和特许 | 2 | 6.1.1 质量一致性测试的减少 | 5 |
| 3.5 优先顺序 | 3 | 6.1.2 审核计划 | 5 |
| 3.6 鉴定评估 | 3 | 附录A | 6 |
| 3.6.1 自我申明 | 3 | | |
| 3.6.2 自我声明中产品特性的验证 | 3 | | |
| 3.6.3 自我声明中的质量概况验证 | 3 | | |
| 3.6.4 自我声明中的产品性能特性的验证 | 3 | | |
| | | 表 | |
| | | 表A-1 印制电路制造 – 潜在原因和后果矩阵表 ... | 9 |